

Title (en)
COMPOSITIONS OF POLY(IMIDES) HAVING PHENYLINDANE DIAMINES AND/OR DIANHYDRIDE MOIETIES IN THE POLY(IMIDE) BACKBONE.

Title (de)
ZUSAMMENSETZUNGEN VON POLYIMIDEN MIT PHENYLINDANDIAMINEN UND/ODER DIANHYDRIDGRUPPIERUNGEN IM POLYIMIDSKELETT.

Title (fr)
COMPOSITIONS DE POLY(IMIDES) POSSEDANT DES DIAMINES DE PHENYLINDANE ET/OU DES MOITIES DE DIANHYDRIDE DANS LA COLONNE VERTEBRALE DU POLY(IMIDE).

Publication
EP 0207981 A1 19870114 (EN)

Application
EP 86900703 A 19851231

Priority
US 68878385 A 19850104

Abstract (en)
[origin: WO8604079A1] Novel compositions of a poly(imide) selected from poly(imides) having phenylindane diamine and/or dianhydride moieties in the poly(imide) backbone and a polymeric component comprising: a) a poly(etherimide); b) a poly(sulfone); c) a poly(aryl ether ketone); d) a poly(carbonate); or e) a poly(arylate); and the compositions which have been cured. The compositions are useful as adhesives, coatings and matrix resins for fiber reinforced composites. The invention also relates to a multi-layered article for use in electronic devices, the article comprising a plurality of layers each comprising a cured composition of the invention with one or more intervening layers of conductive or semi-conductive material.

Abstract (fr)
Nouvelles compositions à base d'un poly(imide) sélectionné parmi des poly(imides) possédant des diamines de phénylindane et/ou des moitiés de dianhydride dans la colonne vertébrale du poly(imide) et un composant polymère comprenant a) un poly(étherimide); b) un poly(sulfone); c) un poly(aryl éther cétone); d) un poly(carbonate) ou e) un poly(arylate), ainsi que les compositions polymérisées. Ces compositions sont utiles comme adhésifs, revêtements et résines matricielles pour composites renforcés par des fibres. Est également décrit un article multicouche destiné à être utilisé dans des dispositifs électroniques, l'article comprenant une pluralité de couches comprenant chacune une des compositions ci-décrites polymérisées avec une ou plusieurs couches intercalées de matériau conducteur ou semi-conducteur.

IPC 1-7
C08L 69/00; **C08L 71/04**; **C08L 77/00**; **C08G 65/48**; **C09J 3/14**; **B05D 3/02**

IPC 8 full level
B05D 7/24 (2006.01); **C08K 7/02** (2006.01); **C08L 67/02** (2006.01); **C08L 69/00** (2006.01); **C08L 71/00** (2006.01); **C08L 71/08** (2006.01); **C08L 71/12** (2006.01); **C08L 79/08** (2006.01); **C08L 81/00** (2006.01); **C08L 81/06** (2006.01); **C08L 101/00** (2006.01); **C09D 5/24** (2006.01); **C09D 169/00** (2006.01); **C09D 179/08** (2006.01); **C09J 167/00** (2006.01); **C09J 179/08** (2006.01); **H01B 3/30** (2006.01); **H01L 23/12** (2006.01); **H05K 1/03** (2006.01)

CPC (source: EP)
C08L 79/08 (2013.01); **C08L 101/00** (2013.01)

Designated contracting state (EPC)
AT BE CH DE FR GB IT LI NL SE

DOCDB simple family (publication)
WO 8604079 A1 19860717; EP 0207981 A1 19870114; EP 0207981 A4 19870706; JP S62501370 A 19870604

DOCDB simple family (application)
US 8502588 W 19851231; EP 86900703 A 19851231; JP 50061386 A 19851231